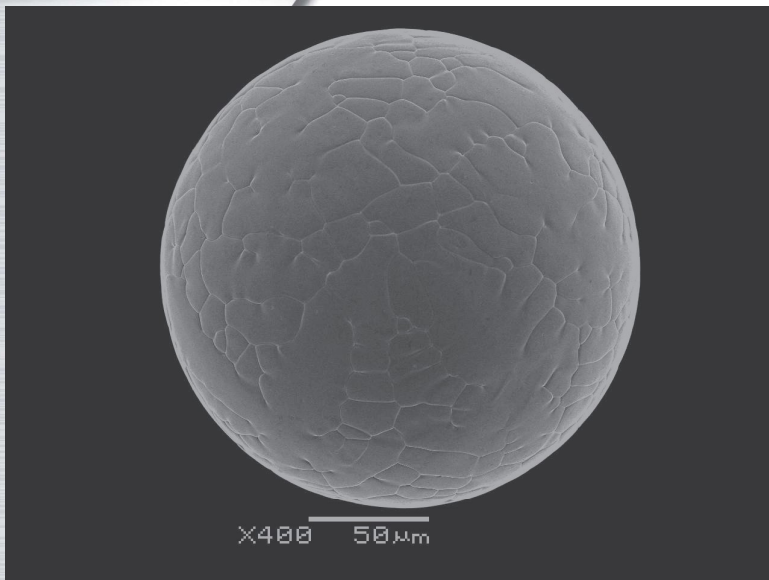


BGA/CSP 用 Cu コアボール

Copper Core Ball for BGA, CSP

Cu コアボール

Copper Core Ball

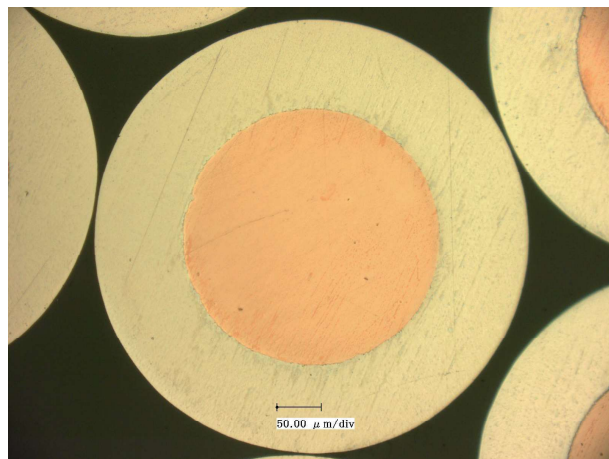


特長 Advantages

Cu ボール表面は平滑です。
Smooth surface of Cu ball.

厚メッキが可能です。
Possible to plate Cu ball thickly.

Cu ボール以外へのメッキも可能です。
Possible to plate the material besides for Cu ball.

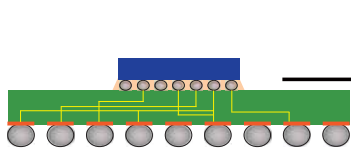


銅ボール径 Copper Ball Diameter	80~760 μm
めっき組成 Plated Layer Composition	Sn、Sn-Ag、Sn-Ag-Cu

※上記以外の組成、粒径につきましてはご相談下さい。

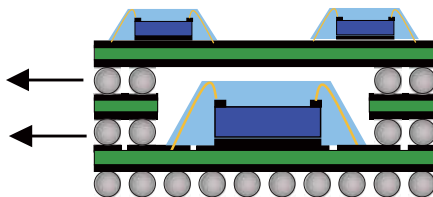
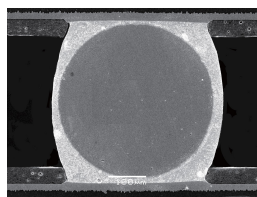
※ Please ask us to manufacture for the other compositions and particle diameter.

アプリケーション Applications



**Cu コアボールが潰れない事により
パッケージと基板の距離が安定し短絡が防げる。**

By Cu core ball that does not collapse during reflow,
it becomes stable distance between package
and circuit board, and it can prevent short circuits.



**Cu コアボールを使用することにより、
パッケージと基板の間のクリアランスを
維持でき、3D 実装が可能となる。**

By using Cu core ball, it can maintain
the clearance between package and
circuit board, and it possible
to make 3D implementation.



FUKUDA
FUKUDA METAL FOIL & POWDER CO., LTD.
福田金属箔粉工業株式会社



福田金属箔粉工業株式会社 HP



UDS 製品紹介 HP